

## **EtherCAT Technology Group gibt neu entwickelten Gerätstandard für die Halbleiterindustrie frei**

**Mit dem kürzlich freigegebenen Geräteprofil ETG.5003-I sowie den zugehörigen neun spezifischen Geräteprofilen liefert die EtherCAT Technology Group (ETG) die Basis für eine neue Tool-Generation in der Halbleiterindustrie und ebnet damit den Weg für eine drastische technologische Weiterentwicklung innerhalb der Branche.**

Die Freigabe der Geräteprofile ermöglicht, dass EtherCAT in Halbleiterfertigungsmaschinen, den so genannten Tools, nicht mehr nur für Motion Control, I/O, Sensoren und Gateways eingesetzt wird, sondern ab sofort auch branchenspezifische Geräte wie Massendurchflussregler oder Vakuumventile direkt ins EtherCAT-System eingebunden werden können. Florian Häfele, der den Arbeitskreis zur Erarbeitung der Profildokumente, die so genannte Semiconductor Technical Working Group, vonseiten der ETG technisch betreut, erklärt: „Mit der Freigabe der in 2012 erarbeiteten Geräteprofile reagieren wir auf den Wunsch der Maschinenbauer, EtherCAT in der Halbleiterbranche flächendeckend auch bei den branchenspezifischen Geräten einsetzen zu können. Spätestens, wenn der Wafer-Durchmesser von 450 Millimetern in alle Anlagen übernommen wurde, erwarten wir, dass EtherCAT durchgängig in fast allen Tools zu finden sein wird.“

Das neue Profil ETG.5003-I (Common Device Profile = CDP) beschreibt die allgemeinen Anforderungen an Geräte, welche in der Spezifikationsserie ETG.5003 veröffentlicht werden. Aktuell betrifft dies neun verschiedene Gerätetypen, welche in den so genannten Specific Device Profiles (SDP) definiert sind. Diese bilden zusammen mit dem CDP die Basis für eine neue Gerätegeneration, auf der künftig auch das Design neuer Tools aufbaut. Die Vorteile des neuen Standards sind so simpel wie überzeugend: Aus EtherCAT-Sicht sind Geräte selbst unterschiedlicher Hersteller bezüglich ihrer Datenstrukturen und Synchronisierungsmodi ab sofort immer gleich. Dies macht zum einen den Austausch und die Handhabung für den Tool-Hersteller deutlich übersichtlicher und einfacher, zum anderen erhalten die industriespezifischen Geräte dadurch ein einheitliches Look and Feel.

Dass die Profile in vergleichsweise kurzer Zeit fertiggestellt wurden, lag nicht zuletzt am starken Engagement der beteiligten Anwender: Firmen wie Applied Materials, Lam Research oder Tokyo Electron nahmen nicht nur aktiv an der Spezifikationsarbeit teil, sondern ermutigten wiederum auch ihre Gerätelieferanten, sich in die Semiconductor Technical Working Group der ETG einzubringen.

ETGI42013

9. Juli 2013 | Seite 2 von 2

## Pressebild



### Bildunterschrift:

Die Semiconductor Technical Working Group der ETG, hier bei einem Treffen am Firmenstandort von Applied Materials in Santa Clara, USA, hat zehn neue Geräteprofile für die Halbleiterindustrie definiert.

### Über die EtherCAT Technology Group (ETG):

Die EtherCAT Technology Group ist eine internationale Anwender- und Herstellervereinigung, in der Anwender aus verschiedenen Branchen mit führenden Automatisierungsanbietern zusammenarbeiten, um die EtherCAT-Technologie zu unterstützen, zu verbreiten und weiterzuentwickeln. Sie wurde im November 2003 gegründet und hat über 2.300 Mitgliedsfirmen aus 56 Ländern.

### Über EtherCAT®:

EtherCAT ist die Industrial Ethernet-Technologie, die sich durch herausragende Performance, niedrige Kosten, flexible Topologie und einfache Handhabung auszeichnet. EtherCAT wurde 2003 erstmals vorgestellt, ist seit 2007 internationaler Standard und wird durch die EtherCAT Technology Group gefördert und weiterentwickelt. EtherCAT ist eine offene Technologie: Jeder darf sie implementieren und nutzen.

→ Weitere Informationen erhältlich im Internet unter [www.ethercat.org](http://www.ethercat.org).

### Pressekontakt:

#### **EtherCAT Technology Group**

Christiane Hebusch  
Ostendstraße 196  
90482 Nürnberg  
Deutschland

Tel.: +49 (0) 9 11 / 5 40 56 226

Fax: +49 (0) 9 11 / 5 40 56 29

[c.hebusch@ethercat.org](mailto:c.hebusch@ethercat.org)

[www.ethercat.org/press](http://www.ethercat.org/press)